

Japanese Language Declaration (日本語宣言書)

委任状： 私は下記の発明者として、本出願に関する一切の手続きを米国特許商標局に対して遂行する弁理士または代理人として、下記の者を指名致します。(弁護士、または代理人の指名及び登録番号を明記のこと)

POWER OF ATTORNEY: As a named inventor, I hereby appoint the following attorney(s) and/or agent(s) to prosecute this application and transact all business in the Patent and Trademark Office connected therewith (list name and registration number)

David L. Tarnoff, Reg. No. 32,383
Yoshio Miyagawa, Reg. No. 43,393
Patrick A. Hilsmier, Reg. No. 46,034
Todd M. Guise, Reg. No. 46,748
Steven J. Roberts, Reg. No. 39,346
Thomas A. Morrison, Reg. No. 46,104
Kiyoe K. Kabashima, Reg. No. 54,874

書類送付先：

Send Correspondence to:
SHINJYU Global IP
c/o SHINJYU GLOBAL IP COUNSELORS,
LLP
1233 Twentieth Street, N.W. Suite 700
Washington, D.C. 20036

直接電話連絡先：(名前及び電話番号)

Direct Telephone Calls to: (name and telephone number)
SHINJYU Global IP
c/o SHINJYU GLOBAL IP COUNSELORS,
LLP
(202) 293-0444

唯一または第一発明者名	Full name of sole or first inventor
	Toshikuni SHINOHARA
発明者の署名	Inventor's signature
日付	Date
	<i>Toshikuni Shinohara</i> 19, Jan, 04
住所	Residence
	c/o ROHM CO., LTD., 21, Saiin Mizosaki-cho, Ukyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto 615-8585 Japan
国籍	Citizenship
	Japanese
私書箱	Post Office Address
	Same as above

Declaration and Power of Attorney For Patent Application

特許出願宣言書及び委任状

Japanese Language Declaration

日本語宣誓書

私は、下欄に氏名を記載した発明者として、以下の通りに宣言します。

私の住所、郵便の宛先及び国籍は、下欄に氏名に続いて記載した通りです。

下記の名称の発明に関し、請求の範囲に記載され、特許出願している発明内容について、私が、最初にして唯一の発明者である（一人の氏名のみが下欄に記載されている場合）か、もしくは、最初にして共同の発明者である（複数の氏名が下欄に記載されている場合）と信じています。

上記発明の明細書（下記の欄で×印がついていない場合は、本書に添付）は、

☐ 年 月 日に提出され、米国出願番号または特許協力条約国際番号を、第 号とし、（該当する場合）年 月 日に補正されました。

私は、特許請求範囲を含む上記訂正後の明細書を検討し、内容を理解していることをここに表明します。

私は、連邦規則法典第37編第1条56項に定義される通り、特許資格の有無について重要な情報を開示する義務があることを認めます。

私は、米国法典第35編第119条(a) - (d) 項または365条(b) 項に基づき、下記の米国以外の国の少なくとも1ヶ国を指定している特許協力条約365(a) 項に基づく国際出願、または外国での特許出願もしくは発明者証の出願についての外国優先権をここに主張するとともに、優先権を主張している、本出願の前に出願された特許または発明者証の外国出願を以下に、枠内をマークすることで示しています。

As a below named inventor, I hereby declare that:

My residence, post office address and citizenship are as stated next to my name.

I believe I am the original, first and sole inventor (if only one name is listed below) or an original, first and joint inventor (if plural names are listed below) of the subject matter which is claimed and for which a patent is sought on the invention entitled:

PLASMA PROCESSING APPARATUS

the specification of which is attached hereto unless the following box is checked:

☐ was filed on _____ as United States Application Number or PCT International Application Number _____ and was amended on _____ (if applicable)

I hereby state that I have reviewed and understand the contents of the above identified specification, including the claims, as amended by any amendment referred to above.

I acknowledge the duty to disclose information which is material to patentability as defined in Title 37, Code of Federal Regulations, Section 1.56.

I hereby claim foreign priority under Title 35, United States Code, Section 119(a) -(d) or 365(b) of any foreign application(s) for patent or inventor's certificate, or 365(a) of any PCT International application which designated at least one country other than the United States, listed below and have also identified below, by checking the box, any foreign application for patent or inventor's certificate, or PCT International application having a filing date before that of the application on which priority is claimed.

Japanese Language Declaration (日本語宣誓書)

Prior foreign applications

先の外国出願

JP Pat. Appln. No.

2003-022072

(Number)

(番 号)

JAPAN

(Country)

(国 名)

01/30/03

(Month/Day/Year Filed)

(月/日/年の出願)

Priority claimed

優先権の主張

☒

Yes

あり

☐

No

なし

2003-022073

(Number)

(番 号)

JAPAN

(Country)

(国 名)

01/30/03

(Month/Day/Year Filed)

(月/日/年の出願)

☒

Yes

あり

☐

No

なし

2003-022074

(Number)

(番 号)

JAPAN

(Country)

(国 名)

01/30/03

(Month/Day/Year Filed)

(月/日/年の出願)

☒

Yes

あり

☐

No

なし

2003-022075

(Number)

(番 号)

JAPAN

(Country)

(国 名)

01/30/03

(Month/Day/Year Filed)

(月/日/年の出願)

☒

Yes

あり

☐

No

なし

2003-022076

(Number)

(番 号)

JAPAN

(Country)

(国 名)

01/30/03

(Month/Day/Year Filed)

(月/日/年の出願)

☒

Yes

あり

☐

No

なし

私は、第35編米国法典119条(e)項に基づいて下記の米国特許出願規定に記載された権利をここに主張致します。

I hereby claim the benefit under Title 35, United States Code, Section 119(e) of any United States provisional application(s) listed below.

(Application No.)

(出願番号)

(Filing Date)

(出願日)

(Application No.)

(出願番号)

(Filing Date)

(出願日)

私は、下記の米国法典第35編第120条に基づいて、下記の米国特許出願に記載された権利、または米国を指定している特許協力条約365条(c)に基づく権利をここに主張します。また、本出願の各請求範囲の内容が米国法典第35編112条第1項又は特許協力条約で規定された方法で先行する米国特許出願に開示されていない限り、その先行米国出願書提出日以降で本出願書の日本国内または特許協力条約国際提出日までの期間中に入手された、連邦規則法典第37編1条56項で定義された特許資格の有無に関する重要な情報について開示義務があることを認識しています。

I hereby claim the benefit under Title 35, United States Code, Section 120 of any United States application(s), or 365(c) of any PCT International application designating the United States, listed below and, insofar as the subject matter of each of the claims of this application is not disclosed in the prior United States or PCT International application in the manner provided by the first paragraph of Title 35, United States Code Section 112, I acknowledge the duty to disclose information which is material to patentability as defined in Title 37, Code of Federal Regulations, Section 1.56 which became available between the filing date of the prior application and the national or PCT International filing date of application.

(Application No.)

(出願番号)

(Filing Date)

(出願日)

(Status: Patented, Pending, Abandoned)

(現況：特許許可済み、係属中、放棄済み)

私は、私自身の知識に基づいて本宣言書中で私が行う表明が真実であり、かつ私の入手した情報と私の信じているところに基づく表明が全て真実であると信じていること、さらに故意になされた虚偽の表明及びそれと同等の行為は、米国法典第18編第1001条に基づき、罰金または拘禁、もしくはその両方により処罰されること、そしてそのような故意による虚偽の声明を行えば、出願した、または既に許可された特許の有効性が失われることを認識し、よってここに上記のごとく宣誓を致します。

I hereby declare that all statements made herein of my own knowledge are true and that all statements made on information and belief are believed to be true; and further that these statements were made with the knowledge that willful false statements and the like so made are punishable by fine or imprisonment, or both, under Section 1001 of Title 18 of the United States Code and that such willful false statements may jeopardize the validity of the application or any patent issued thereon.